

特点:

- 频率范围: 1~7GHz
- 动态范围: 30dB
- 检波平坦度: 2dB
- 低耗散功率: +5V@3mA
- SMT 封装
- 封装尺寸: 4×4×1.6mm³
- 产品执行标准为 GJB8481-2015

性能参数: (TA=+25°C, 50Ω 系统)

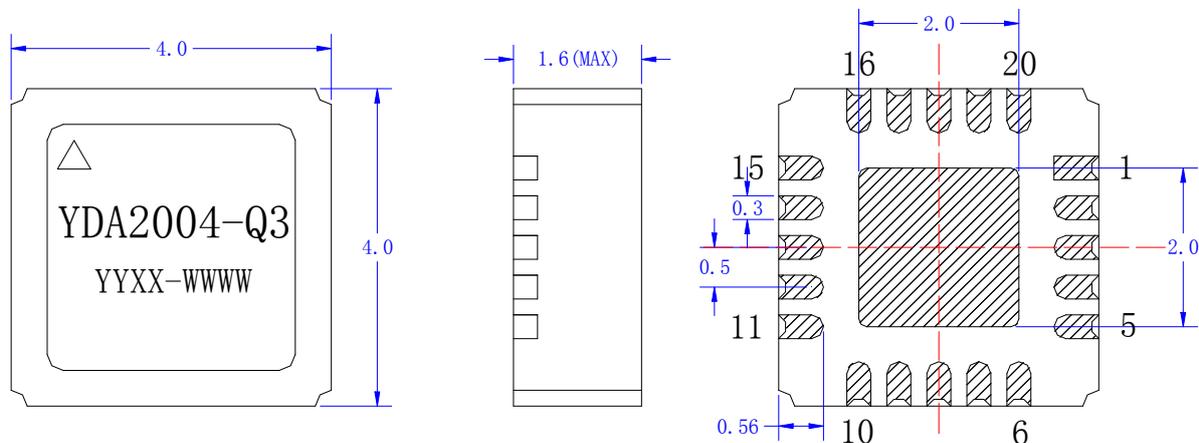
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	V _{dd} =+5.0V Z _{in} = 50Ω f=1~7GHz	1		7	GHz	
检波平坦度				2.0	3.0	dB	
输入功率范围	P _{in}		-10		20	dBm	
输出电压范围	V _o		0.05		3.8	V	
上升沿	T _{rf1}	脉冲信号输入			50	ns	
下降沿	T _{rf2}				200	ns	
工作电压	V _{dd}		+4.75	+5	+5.25	V	
电源电流	I _{cc}	V _{dd} =+5.0V		3	5	mA	
工作温度	T		-55		+85	°C	
质量	m				2	g	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
电源电压	+5.5	V	输入射频功率	22	dBm
储存温度	-55~+100	°C			

封装外形图:

单位: mm 公差: ±0.2mm



字符标志:

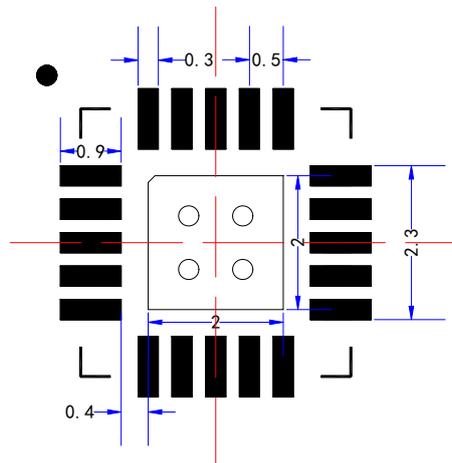
YDA2004-Q3	产品型号
Δ	1脚
YYWW	批次号
XXX	序列号

引脚定义:

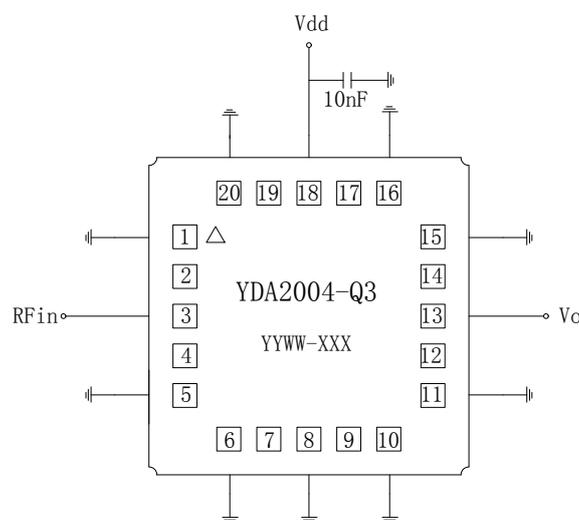
引脚	定义	备注
3	RF IN	射频输入端
13	Vo	检波电压输出端
18	Vdd	电源电压端
2/4/7/9/12/14/17/19	NC	
1/5/6/8/10/11/15/16/20/底部	GND	接地端

推荐焊盘图:

单位: mm 公差: ±0.2mm

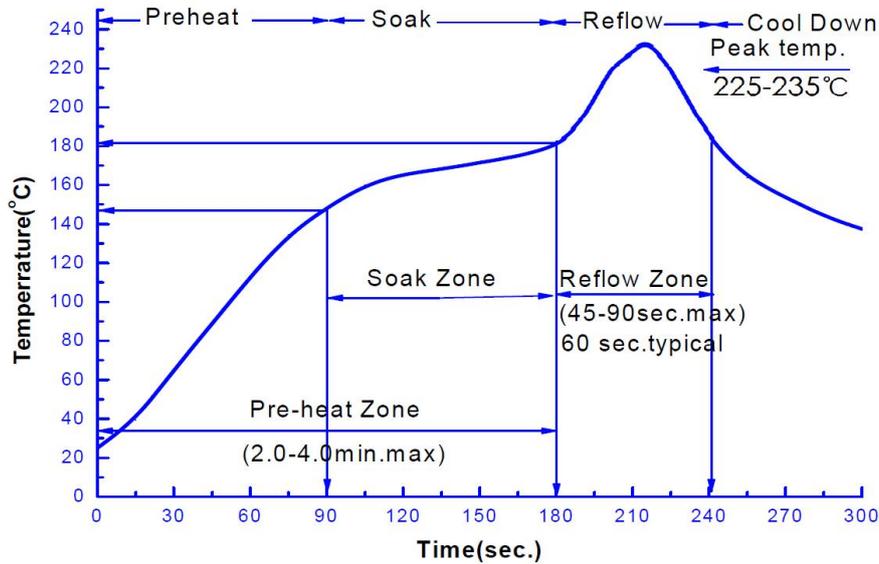


推荐装配电路:



产品使用注意事项:

- 1.产品属于静电敏感器件，耐静电能力 $\leq 250V$ ，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
- 2.产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域），为了保证连接良好，底部引脚焊好之后，需对侧面引脚进行补焊；
- 3.产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 235℃。

- 4.如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。